

METHOD FOR FORMING SOLDER SHEET

Patent Number: JP5069190
Publication date: 1993-03-23
Inventor(s): YANAGIHARA HIROSHI
Applicant(s): TANAKA KIKINZOKU KOGYO KK
Requested Patent: ☐ JP5069190
Application Number: JP19910245142 19910830
Priority Number(s):
IPC Classification: B23K35/40; B23K3/06; C23C14/18; C23C18/50
EC Classification:
Equivalents:

Abstract

PURPOSE: To forming a solder sheet standing in a row with high dimensional precision and high positional precision and to provide a simple and easy method for the above.

CONSTITUTION: A fine film of solder is formed on a base plate of a smooth surface of 'Teflon(R)', etc., with a sputtering method, etc., next, photoresist is coated on the surface of this film, and dried, next, the photoresist except the pattern part is removed by using a negative film protted with the required pattern as a mask, exposing with a exposure phenomenon, the object is achieved by removing the resist after etching this exposed fine film part with pickling, etc.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁(J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-69190

(43)公開日 平成 5 年(1993) 3 月23 日

(51)Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
B 2 3 K 35/40	3 4 0 Z	7362-4E		
3/06	Z	9154-4E		
C 2 3 C 14/18		8414-4K		
18/50		8414-4K		
// B 2 3 K 101:42				

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 3 頁)

(21)出願番号 特願平3-245142

(22)出願日 平成 3 年(1991) 8 月30 日

(71)出願人 000217228

田中貴金属工業株式会社

東京都中央区日本橋茅場町 2 丁目 6 番 6 号

(72)発明者 柳原 浩

神奈川県平塚市新町 2 番73号 田中貴金属
工業株式会社技術開発センター内

(54)【発明の名称】 ハンダシート形成法

(57)【要約】

【目的】 整列されたハンダシートを寸法精度、位置精度の高い状態で形成させる簡便な方法を提供することを目的とする。

【構成】 テフロン等の表面の滑らかな基板上にスパッタリング法等でハンダの薄膜を形成し、次いでフォトリソを薄膜の表面に塗布、乾燥し、次いで所望のパターンが描画されているネガフィルムをマスクに使用し、露光現像してパターン部以外のレジストを除去し、酸等で露出した薄膜部をエッチングしたのちレジストを除去することで目的を達成する。

の方法によれば、従来プレスで打抜かれたハンダシートは整列されていないため、使用に際し整列させることが必要であったり、複雑な形状に打抜くためにそれぞれの型が必要となり作業が繁雑で、しかもハンダの材質によ

ってはプレス加工することが困難なものもあったが、これらの課題をすべて解決することができるという画期的な方法といえる。